



## Editorial

Chers lecteurs/lectrices,

Cette édition trimestrielle n°93 est l'occasion de vous présenter les actions du trimestre passé et vous faire un point d'avancement et de perspectives pour les mois à venir.

**THERMAL 2026** s'est déroulé les 25 et 26 mars avec un toujours un franc succès. Jean-Yves nous en fait un premier compte-rendu.

**MiNaPAD 2026** revient les 03 et 04 juin prochain non plus au Word Trade Center mais à la maison Minatec à Grenoble.

Il y aura 36 exposants industriels et 8 sponsors. Le programme est diffusé avec 37 présentations et 3 keynotes. Il est temps de vous inscrire !

En fin d'année 2026, le jeudi 26 Novembre, nous retrouverons **POWER** à Tours. L'appel aux résumés a été diffusé et la commercialisation des stands est en cours.

Les adhésions à IMAPS pour 2026 restent ouvertes avec des tarifs inchangés par rapport 2025 (voir dernière feuille de ce document). Ces adhésions sont importantes pour la vitalité de notre association et elles permettent aux adhérents, notamment d'avoir accès à notre base de données et avoir un tarif d'inscription réduit aux conférences.

Vous retrouverez enfin plusieurs communications aux dernières pages : PEPR électronique, Ecole Thématique Packaging (dont certains membres du bureau interviendront), bibliographie)

*"Everything in electronics between the chip and the system" (ISHM – Une définition du Packaging)*

**Pascal COUDERC**

## Grain de sel

Tel un coucou, je m'insère à la fin de cet éditorial pour vous inciter à découvrir plus bas dans cette lettre d'information, la start-up HOOKE Electronics qui propose ses conseils dans les assemblages électroniques. Conformément à l'article 2 des statuts de l'association, « *IMAPS France continue d'avoir pour objet de permettre les échanges d'information concourant aux progrès de la micro-électronique, de l'interconnexion, et du packaging, par l'organisation de colloques nationaux et la participation à des congrès internationaux, par la mise en place d'une documentation technique et scientifique à la disposition de tous les hommes de l'art et par la rédaction de documents techniques.* »

**Jean-Yves SOULIER**  
Trésorier IMAPS France

## Calendrier IMAPS France 2026/2027

<b>MiNaPAD</b> <b>03 au 04 Juin 2026</b> <b>Grenoble</b>
<b>POWER</b> <b>26 Novembre 2026</b> <b>Tours</b>
<b>Assemblée Genrale IMAPS France</b> <b>Septembre 2026</b>
<b>THERMAL</b> <b>17 au 18 Mars 2027</b> <b>La Rochelle</b>

**Prochaine édition: Juillet 2026**

# Premier compte rendu du 19<sup>th</sup> European ATW on Micropackaging and Thermal Management

25 -26 mars 2026  
Mercure La Rochelle



## et co-présidé par :

Bruno LEVRIER (BL Expertise)

Jean-Pierre FRADIN (ICAM Toulouse)

Jean-Yves SOULIER (Safran Data Systems)

## Sponsorisé par



Nous nous étendrons plus longuement dans notre Newsletter N°94 de juillet prochain sur les enseignements des 25 conférences de ce 19<sup>ème</sup> workshop thermique, une fois récupéré les présentations des conférenciers. Nous pouvons toutefois faire un premier débriefing à chaud.

Au risque de radoter, une fois de plus, le succès de nos événements tient d'abord à la présence d'un grand nombre de conférenciers, auditeurs et exposants et aux nombreux contacts que les uns et les autres peuvent prendre. Avec **plus de 90 personnes sur les deux jours**, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que ce workshop fut un très bon cru. Des industriels et conférenciers comme **SLB** (ex-Schlumberger) étaient présents. Les véhicules plus électriques boostant les activités en matière de refroidissement, **VALEO** et l'autre géant des équipements automobiles, **SCHAEFFLER** étaient aussi présents. **THALES, AIRBUS et SAFRAN** étaient également représentés. L'intégration de processeurs dissipant 10 fois plus de puissance qu'il y a 20 ans dans des environnements inchangés, appelle de nombreuses réflexions et impose la mise en œuvre de solutions que l'aéronautique rechigne à embarquer. Les caloducs oscillants ont fait l'objet

de présentation de l'exposant THERMAVANT, de Safran Electronics & Defense en partenariat avec le LET de l'ENSMA Poitiers, l'université japonaise Aoyama Gakuin. Saisissant le taureau par les cornes, Muriel Sabah s'est attachée à caractériser la tenue en vibration de caloducs insérés dans les châssis des nouveaux FADEC, rappelant que les environnements thermique et vibratoire n'étaient pas découplés. La mise en œuvre d'une nouvelle technologie appelant une qualification relativement à une trentaine de points d'attention, recensés par les normes aéronautiques civiles ou militaires.

Il me faut en général beaucoup de temps et beaucoup de répétitions pour comprendre les choses. Et depuis de nombreux workshops, je me pose la question de comprendre pourquoi depuis quasiment 2006, nous assistons à de nombreuses présentations sur les interfaces thermiques. Il m'est alors revenu à l'esprit une conférence de feu Avram Bar Cohen qui, il y a une quinzaine d'années lors d'une journée technique chez mes confrères de THALES, expliquait que le refroidissement avait un coût. Il évoquait déjà les data centers, aujourd'hui en pleine croissance avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Si l'on réduit le gradient thermique au franchissement d'une interface, sachant qu'il ne faut pas dépasser la température limite d'un processeur ou d'un IGBT, il sera moins difficile (débit, nature du fluide, mise en mouvement du fluide) et donc moins coûteux de mettre en œuvre une source froide pour ramasser et évacuer les Watts.

Je n'en dis pas plus pour ne pas bâcler ce compte-rendu et dévaloriser les très nombreuses présentations sur lesquelles je reviendrai en juillet prochain et je n'oublie pas enfin de remercier une nouvelle fois SERMA et HUAWEI qui auront sponsorisé l'événement.

La tenue d'un workshop tous les ans appelle une gestion du planning au cordeau. Le 19<sup>ème</sup> workshop s'est achevé il y a à peine 3 semaines, nous préparons déjà le 20<sup>ème</sup> qui se tiendra les **17 et 18 mars 2027**, toujours à La Rochelle. Les organisateurs Alexandre Val, Pascal Couderc, Reynald Deroche, Nicole Salvat sont déjà sur le pont.

**Jean-Yves Soulier**

## **Prochaines Dates clés THERMAL 2027**

**Appel à communication** : Juillet 2026

**Sélection des papiers** : Janvier 2027

**Notification des orateurs** : fin janvier 2027

**Programme et ouverture des inscriptions** : Février 2027

# 12ème Forum MiNaPAD 2026



Maison Minatec

**et co-présidé par :**

**General chair :**

Valérie VOLANT (ST Microelectronics)

**Technical chairs :**

Jean-Luc DIOT (Assemblinno),  
Romain COFFY (STMicroelectronics),  
Jean-Charles SOURIAU (CEA-LETI),  
Jean-François SAUTY (ASE group),  
Laurent MENDIZABAL (CEA-LETI),  
Alexandre VAL (VALEO).

**Parainé par :**



Et c'est parti pour l'édition 2026 de la conférence MiNaPAD. Suite à la fermeture du WTC (World Trade Center), nous revenons sur la maison Minatec comme dans les années 2011 à 2014.

Les locaux sont bien adaptés à la jauge de MiNaPAD (160 participants et 36 stands d'exposants) et sont bien situés, à 10 minutes à pied de la gare de Grenoble et des hôtels les plus proches.

**Le programme est défini et a été diffusé le 16 avril pour démarrer les inscriptions.**

Il y aura 3 keynotes et 37 présentations réparties en sessions parallèles.

**Les thèmes sont les suivants :**

- Dispensing technologies
- Attachment materials
- Sustainability
- Sintering materials
- Packaging Architecture
- Reliability
- Process optimization
- Characterization
- 3D advanced
- Advanced packaging
- PCB substrates
- Interconnections
- Fan-Out
- Flip-Chip
- Heterogeneous Integration

Une session spéciale d'information sur des projets packaging France PERP (InPack et ReNapack) aura lieu après les sessions du 3 juin.

Le dîner de Gala réalisé Au Domaine de Charmeil (38210 St Quentin sur Isère) dans un cadre rafraichissant et reposant.

Une organisation du transport par Bus est mise en place pour vous permettre de profiter au mieux de cette soirée.



## Stands MinaPad 2026

Nous aurons 36 exposants ! C'est inhabituel mais nous allons tester cette nouvelle jauge.

De nouveaux exposants venant de la conférence EMPC2025 se sont portés candidats très rapidement. Et nous n'avons pas pu satisfaire toutes les demandes.

La liste des exposants est ci-dessous

Booth number	Company
1	CEA
2	ELECTRON MEC
3	MST
4	MICRONOR
5	DYCONEX
6	FINETECH
7	KYOCERA
8	SET
9	SERMA
10	INPACK
11	AEMTEC
12	METRONELEC
13	ACCELONIX
14	ROARTIS
15	ONTOS
16	CICOR
17	SYNERGIE CAD
18	BIESTERFELD
19	ELEMCA
20	CDS

21	HEF
22	UNITEMP
23	PROTAVIC
24	TAIPRO
25	AMADYNE
26	PLASMATREAT
27	HYBRID SA
28	EGIDE
29	CCI EUROLAM
30	GS SWISS
31	INTRASPEC
32	DISCO
33	ELEMATEC
34	ACB
35	ASE
36	INSIDIX

La grille tarifaire a été optimisée pour rendre attractif notre évènement par rapport aux pratiques d'autres événements similaires en Europe :

L'entrée sera gratuite pour les étudiants, doctorants s'inscrivant à l'une des deux journées ainsi que leurs encadrants pédagogiques.

L'entrée est gratuite aux membres IMAPS retraités.

Les orateurs, sponsors, modérateurs des sessions ont un tarif unique à 200 Euros.

Les membres IMAPS ont pour tarif 400 Euros.

Si vous identifiez une offre présentant des prestations et une qualité équivalente à un tarif plus avantageux, nous vous serions bien reconnaissants de nous en informer !

**L'équipe MiNaPAD**

# 15<sup>ème</sup> Forum Power 2026

## From Nano to Macro Power Electronics & Packaging Workshop 26 Novembre 2026

Greman, Université de Tours (37)



**Evénement sponsorisé par :**



### Comité technique

#### Chairman

Laurent BARREAU (ST Microelectronics Tours)

#### Co-Chairman

Daniel ALQUIER (GREMAN Laboratory)

Franck DOSSEUL (VERMON)

#### Membres

Lars BOETTCHER (FRAUNHOFER Institute)

Cyril BUTTAY (AMPERE Laboratory)

Jean-Luc DIOT (Private)

Guo-Quan LU (VIRGINIA TECH)

Alexandre SEIGNEURIN (ST Microelectronics)

Le premier appel à papiers vient d'être diffusé. Mais le succès de cet appel provient également de vos réseaux respectifs, n'hésitez pas à relayer l'information !

Pour rappel, le contenu de l'appel à papier porte sur **les sujets suivants** :

-Power management for transportation and industrial systems

-Energy harvesting systems, from nano to macro (smart grid, wind energy, photovoltaic, etc...)

-Energy conversion systems – from power to emission (lighting, ultrasonic, infrared, etc...)

**Ces sujets peuvent être développés autour de plusieurs thèmes :**

-New materials and substrates dedicated to power electronics

-Thermal or thermo-mechanical or regulatory constraints (RoHS regulation, REACH, etc...)

-Dedicated technologies for integration and optimization of power systems, including passive components (weight and size reduction, yield improvement, efficiency, etc...)

-Innovative technologies, materials and processes dedicated to interconnection and packaging (die attach, bonding wire & ribbon wires, 3D power components, etc...)

-Reliability and failure modes (impacts linked to technologies, thermal constraints, etc...)

-High current and high voltage or extremely high voltage: impact on packaging technologies

### **Dates clés POWER 2026**

**Commercialisation des stands** : Avril 2026

**Ouverture de l'appels à résumés** : Avril 2026

**Sélection des papiers** : Septembre 2026

**Notification des orateurs** : fin Septembre 2026

**Programme** : Début Octobre 2026

Cordialement,

**L'équipe de POWER 2026**

# COMMUNICATION

## Présentation de la société

### Hooke Electronics



**Hooke Electronics** est une société de conseil spécialisée dans le domaine de la durabilité des assemblages électroniques opérant en environnements sévères. La société a été créée en juin 2024 par Jean-Baptiste LIBOT et Philippe MILESI.

**Jean-Baptiste LIBOT** a d'abord travaillé pour Airbus Group avant de rejoindre le *Center for Advanced Life Cycle Engineering*, centre de recherche américain reconnu mondialement pour son expertise dans la fiabilité électronique. Il a ensuite réalisé sa thèse en collaboration avec Safran Electronics & Defense et l'Institut National Polytechnique de Toulouse avec pour sujet la caractérisation et le développement de modèles de durabilité thermomécaniques et vibratoires pour l'alliage de brasure sans plomb SAC305. Il a par la suite intégré Safran Electronics & Defense en tant que spécialiste de la durabilité des assemblages électroniques où il a contribué à la montée en maturité et au déploiement des technologies sans plomb.

**Philippe MILESI** a effectué toute sa carrière longue de 42 années chez Safran Electronics & Defense, où il a développé une expertise reconnue dans le domaine de la durabilité des assemblages électroniques et des systèmes opérant en environnements climatiques, thermiques et vibratoires

Fort de leur expertise en sciences des matériaux et de leur connaissance industrielle, tant au niveau des circuits imprimés, des technologies de composants et des alliages de brasure, ils proposent aujourd'hui à leurs clients des solutions permettant de garantir la durabilité des équipements électroniques tout au long de leur cycle de vie. Ces solutions s'articulent autour de quatre activités principales :

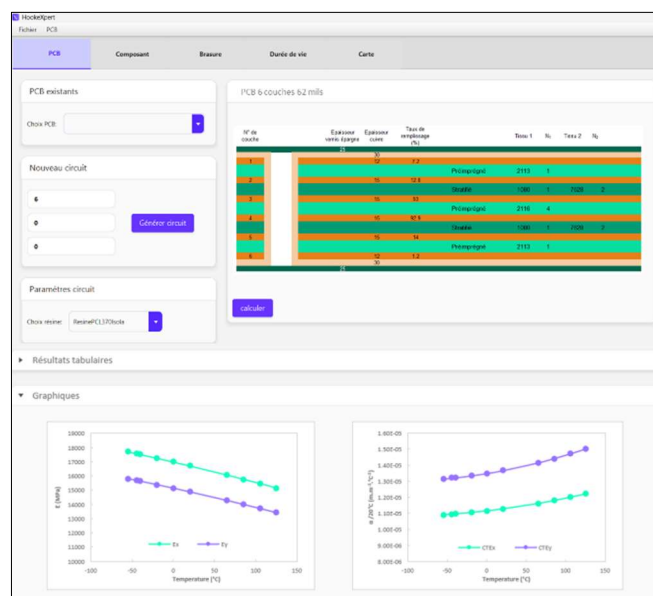
- **Logiciel HookeXpert :**



HookeXpert est un logiciel de calcul de la durée de vie de cartes électroniques assemblées avec les alliages de brasure sans plomb SAC305 et étain plomb SnPb. Il permet de modéliser avec précision

l'empilement des circuits imprimés ainsi que la structure des composants (BGA, QFN, LCC, etc.) afin de calculer leurs propriétés thermomécaniques et mécaniques, puis de spécifier le profil de vie de l'équipement analysé afin de calculer sa durée de vie. En fonction du résultat et de l'objectif de durée de vie du produit, il est possible de proposer des solutions permettant d'augmenter la durée de vie des assemblages électroniques (colle, *underfill*, etc.).

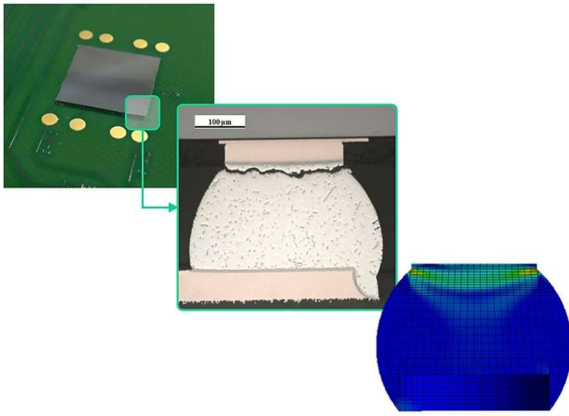
*Exemple de modélisation d'un circuit imprimé et calcul du module de Young et du coefficient de dilatation thermique associé (CTE) :*



Pour en savoir plus : <https://www.hooke-electronics.com/>

- **Conseil :** Hooke Electronics propose ses services de conseil qui vont de la définition de campagnes d'essais de caractérisation des matériaux et d'essais accélérés (cycles thermiques, vibrations) jusqu'au développement de modèles statistiques de durée de vie. Parmi les outils à disposition, le logiciel éléments finis Ansys Workbench permet d'évaluer l'endommagement des brasures en fonction de contraintes environnementales données.

*Exemple de modélisation éléments finis d'une bille de brasure permettant de corréler le mode de défaillance à l'endommagement thermomécanique subi au cours de cycles thermiques :*



Les différents modèles développés associés aux bons outils permettent de proposer des solutions robustes afin d'aider les clients à bien dimensionner leurs équipements électroniques en fonction de leur profil de vie.

- **Formation** : Hooke Electronics propose également des formations afin de faire monter en compétences les équipes travaillant sur la conception et la tenue des équipements électroniques utilisés en environnements sévères. Ces formations certifiées Qualiopi peuvent être adaptées en fonction des besoins des entreprises. Voici les formations « catalogue » proposées actuellement :

- Les bases de la fiabilité des assemblages électroniques (0,5 jour)
- Evaluation des propriétés matériaux des circuits imprimés (1 jour)
- Electronique sans plomb - De la microstructure aux modèles de fiabilité (2 jours)

- **Documentation technique** : en complément des formations et toujours dans une optique de capitalisation des connaissances, Hooke Electronics propose également des guides techniques sur les circuits imprimés. Ils présentent différentes méthodologies d'évaluation des propriétés physiques des stratifiés / préimprégnés et des circuits imprimés multicouches. Ces guides techniques ont pour objectif de donner les informations nécessaires aux ingénieurs / concepteurs devant assurer la fiabilité des équipements électroniques tout au long de leur cycle de vie.



N'hésitez pas à contacter Hooke Electronics pour vos projets relatifs à la durabilité des assemblages électroniques.

**Contacts :**

Jean-Baptiste LIBOT  
[jean-baptiste.libot@hooke-electronics.com](mailto:jean-baptiste.libot@hooke-electronics.com)  
 06 35 33 19 56  
 Philippe MILESI  
[philippe.milesi@hooke-electronics.com](mailto:philippe.milesi@hooke-electronics.com)  
 06 75 17 00 86

# Communication Ecole Thematique Packaging des composants électroniques



Les objectifs de l'école sont de donner aux participants et participantes une vision d'ensemble du packaging, qu'il s'agisse d'en connaître les technologies de fabrication, d'en caractériser les performances, ou de concevoir une solution de packaging pour un circuit donné.

L'école est ouverte à tous les doctorants, doctorantes, ingénieures et ingénieurs souhaitant découvrir les différents aspects du packaging. Elle inclut des séances de cours ainsi que des travaux pratiques, dans un cadre agréable (massif de la Chartreuse, à proximité de Grenoble).

Les frais d'inscription comprennent la participation à l'école, l'hébergement en pension complète, le transport en car depuis la gare de Grenoble.

Date limite d'inscription : 28/05/2026, effectif limité à 32 personnes.

Catégorie	Tarif
Participants salariés d'établissements privés	1200€
Doctorants	500€
Participants salariés du CNRS	0€
Participants d'autres établissements publics	700€

Programme détaillé, informations pratiques  
et inscriptions sur  
<https://packaging.sciencesconf.org/>



Contact : [cyril.buttay@insa-lyon.fr](mailto:cyril.buttay@insa-lyon.fr)

# PEPR ELECTRONIQUE

Retour sur les journées scientifiques de Lyon

Compte-rendu repris de <https://www.pepr-electronique.fr/retour-sur-les-journees-scientifiques-de-lyon/> , où vous trouverez aussi plus d'informations

## Mercredi 18 mars

Pour commencer, un workshop sur les matériaux semi-conducteurs grande surface organisé notamment par Olivier Ducloux et Sophie Bouchoule, introduit par Hugues Métras et parrainé par Jérôme Faist a captivé son audience au travers de 3 interrogations :

👉 Quels enjeux pour les activités de recherche fondamentale sur les matériaux, en complémentarité avec les acteurs industriels ?

👉 Comment anticiper l'impact de l'IA sur le développement des matériaux semi-conducteurs pour l'électronique ?

👉 Souveraineté économique et stratégique : quels enjeux sur les matériaux semi-conducteurs, quelles filières matériaux à fort impact à horizon 2030-2040 ?

👉 Ce workshop a réuni 250 personnes en présentiel !

Puis 150 participants se sont réunis pour le workshop « Photonique intégrée hétérogène » animé par Mathieu Chauvet, Mehdi Alouini et Yoan Léger.

En parallèle, l'atelier sur « l'électronique de puissance » animé par Cyril Buttay a passionné 90 personnes !

💡 L'après-midi s'est poursuivie par deux keynotes magistrales animées par :

- Yves Brechet pour « De la vue ensemble au souci du détail, une schizophrénie nécessaire »
- Guillaume Pitron pour « Matériaux critiques, quelles stratégies pour la résilience dans les chaînes d'approvisionnement en électronique »

👉 Pour finir cette journée en beauté, les douces mélodies de Paul Chatron-Michaud et Benjamin Bert nous ont emportées pendant le cocktail.

👤 Cette forte mobilisation de la communauté scientifique du PEPR engage cette première journée de façon remarquable en présentiel et à distance avec les 166 personnes connectées !

Merci aux stands de [l'Année de l'Ingénierie](#) et notamment à Laurent Nicolas et à SET d'avoir participé.

## Jeudi 19 mars

Cette deuxième journée scientifique a été un véritable succès, rassemblant des professionnels, des chercheurs, des étudiants et des curieux..., toute une communauté ravie de se retrouver.

🕒 Matinée :

- Mots d'ouverture de nos partenaires que nous remercions de nous avoir chaleureusement accueillis : Gérard PIGNAULT de CPE Lyon, Bruno Masenelli de INL – CNRS, Marie-Christine Baietto de INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Christophe CORRE et Bruno Montcel.
- Discours encourageants de nos institutionnels : Jean-Noël Buis, Laurent Béchou de la Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI), Jean-Philippe Bourgoin du CEA, Lionel Buchaillet de #CNRSIngénierie, Olivier Ducloux de L'Agence de programme ASIC et Sandrine Beauvils de la Fédération de l'Électronique Française

💡 Le PEPR Électronique 4 ans après son démarrage par Isabelle Sagnes et Thomas Ernst

💡 Des présentations flash captivantes des travaux des 97 doctorants et ingénieurs, mettant en avant leur recherche. Le challenge étant de présenter en 1 minute son poster. Des prix récompenseront les 10 meilleurs après le vote des participants.

🕒 Déjeuner autour des posters : Un moment convivial, passionné et idéal pour découvrir les recherches en cours, échanger des idées et discuter des dernières avancées.

👤 Après-midi :

- Des tables rondes enrichissantes avec nos copilotes sur les thématiques du PEPR animées par François Legrand avec notamment un quizz sur des images mystères.
- La remise des prix pour les lauréats des meilleurs posters, soulignant le vivier que représente cette rafraichissante relève.

👉 Bravo à Pomme Hirschauer, Huiru Ren, Thomas Perriguy, Colin Guirardel, Mamadou Hawa Diallo, Thomas Buttiens, Rachel Grosset Darracq, Tania AIMoussi, Yannis Billiet et Thomas Valentin

# Accès articles IMAPS

Vous avez un accès libre aux revues en allant : [Advanced Packaging & Semiconductor Publications | IMAPS](#)



Dans le numero 2026 Issue 6 il y a 2 articles intéressants :

## Cost-Effective High-Performance Flip Chip MicroLeadFrame® (fcMLF®) Package Introduction

**Abstract :** The demand for cost-effective leadframe packages continues to grow, particularly for automotive and commercial applications. These designs require smaller form factors, enhanced thermal and electrical performance, and proven reliability. Flip chip on leadframe technology offers significant advantages over traditional wire bonded MicroLeadFrame® (MLF®) and high-cost laminate Flip Chip Chip Scale Package (fcCSP) designs, including enhanced thermal and electrical characteristics and reduced package size compared to traditional wirebond solutions such as MLF®. As industry pushes for cost effective solutions targeting thinner and more compact profiles than available in wirebond solutions, flip chip technology enables die size reduction and printed circuit board (PCB) area savings compared to conventional wire-bonded MLF® packages. The use of copper (Cu) pillar bumps supports fine-pitch designs and offers flexibility for fan-in leadframe configurations. The flip chip MicroLeadFrame (fcMLF®) package presents a compelling solution for a wide range of applications, including power management integrated circuits (PMICs), DC/DC converters, and RF switches. As with a traditional MLF® package, Amkor's wettable flank feature, both dimple and step-cut configurations can be supported. A requirement of the automotive industry, the wettable flank enhancement enables Automated Optical Inspection (AOI) for proper fillet formation during the Printed Circuit Board (PCB) solder reflow process without requiring an expensive and complex through board X-Rays process. By leveraging industry-leading flip chip interconnect technology and an established sawn MLF® manufacturing process, fcMLF® packaging delivers a cost-effective, high-performance lead frame packaging solution tailored to meet the evolving needs of modern electronic systems.

## Advanced Packaging Market Trends in the AI Era

**Abstract :** The advanced packaging (AP) market is entering a new phase of robust expansion, driven primarily by the rapid expansion of artificial intelligence (AI) and high performance computing (HPC) applications. Following a market downturn in 2023 caused by global macro economic pressures, the industry rebounded strongly in 2024, surpassing \$50 billion in revenues and achieving approximately 20% year-over-year (YoY) growth. This recovery marks the start of a long-term expansion cycle, with the AP market projected to exceed \$80 billion by 2030, corresponding to a compound annual growth rate (CAGR) of 8.5% from 2024 to 2030. AI workloads impose unprecedented requirements on bandwidth, power efficiency, and integration density, accelerating the adoption of advanced 2.5D and 3D packaging technologies. High-value platforms such as TSMC's CoWoS and SoIC, as well as Intel's EMIB and Foveros, are becoming essential enablers for AI accelerators and chiplet-based architectures. Although datacenter AI is currently the most important driver for advanced packaging, edge AI is also starting to show its prominence and increasing demand for advanced semiconductor architectures. In parallel, industry leaders are expanding capacity and investing in next-generation solutions, including panel-level packaging and co-packaged optics (CPO). Technology roadmaps indicate rapidly increasing package sizes and a growing transition toward glass core substrates, which offer improved dimensional stability and integration potential for optical and high-density interconnects. These trends are driving significant innovation across materials, lithography, and testing, positioning advanced packaging as a central pillar of future AI and HPC system architectures.

# BULLETIN D'ADHESION 2026

- 100 € pour les membres individuels en activité.
- 50 € pour les membres retraités.
- 20 € pour les membres privés d'emploi, étudiants
- 350 €\* Adhésion Société Petite et Moyenne entreprise (effectif <250 personnes)
- 650 €\* Adhésion Société Grande entreprise (effectif >250 personnes)

Date ..... Signature .....

Mme       Mr      Numéro Adhérent .....A020.....  
Nom ..... Prénom.....  
Société .....  
Fonction .....  
Adresse .....  
Code Postal ..... Ville ..... Pays .....  
Tel ..... Email .....

## Adhésion Individuelle :

- Tarif réduit sur tous les événements IMAPS (Europe, Etats-Unis), journée technique, salon MiNaPAD, workshops, salons européens EMPC
- Tarif réduit sur toutes les publications achetées à l'IMAPS.
- Accès à tous les espaces « Members Only » du site web IMAPS et à la base de données « Proceedings »
- Droit de vote pour les élections IMAPS.
- Demande d'emploi postée sur le site IMAPS

## Adhésion Société :

- Tarif IMAPS membres pour tout représentant de votre société pour les conférences organisées par IMAPS France.
- Jusqu'à 10 personnes de votre société identifiées comme membre IMAPS individuel reçoivent l'ensemble des publications d'IMAPS
- Accès 4 fois dans l'année à la liste complète des membres pour un mailing de vos produits réalisé par le bureau IMAPS (adresse électronique des membres IMAPS non fournie).
- Accès illimité à l'Espace membres et à la base de données « Proceedings »
- Possibilité de déposer les offres d'emploi de votre société sur le site.
- Droit de vote aux Assemblées générales (jusqu'à 10 voix).

Inscription et paiement en ligne: [www.france.imapseurope.org](http://www.france.imapseurope.org)